



Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯国际介绍

纽交所: **SMI** 港交所: **981**

2019年2月



安全港声明

(根据1995私人有价证券诉讼改革法案)

本次报告可能载有(除历史资料外)依据1995美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述,包括“二零一九年第一季指引”、“资本开支概要”,乃根据中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯国际使用「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、「期望」、「预测」、「目标」或类似的用语来标识前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况,及货币汇率波动。

除本报告所载的资料外,阁下亦应考虑中芯国际向美国证券交易委员会呈报的其他文件所载的数据,包括本公司二零一八年四月二十七日随表格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报,尤其是「风险因素」一节,以及中芯国际不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他文件(包括表格6-K)。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素,本报告所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心,不应不当依赖该等前瞻性陈述,有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表,倘并无注明日期,则视为于本报告刊发日期发表。除法律可能会有的要求外,中芯国际不承担任何义务,亦无意图,更新任何前瞻性陈述,无论是否有新的信息,将来的事件或是其它原因。

关于非一般公认会计准则(“非公认准则”)的财务计量

中芯国际在此份报告里使用了非公认准则的营运结果测量,包含非公认准则的营运开支,调整后的税息折旧及摊销前利润,以及调整后的税息折旧及摊销前利润率。请协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务测量,具体解释请参阅业绩报告。



- 中国集成电路产业机遇
- 中芯简介
- 中芯业绩
- 成长战略
- 总结

集成电路产业是战略性、基础性和先导性产业



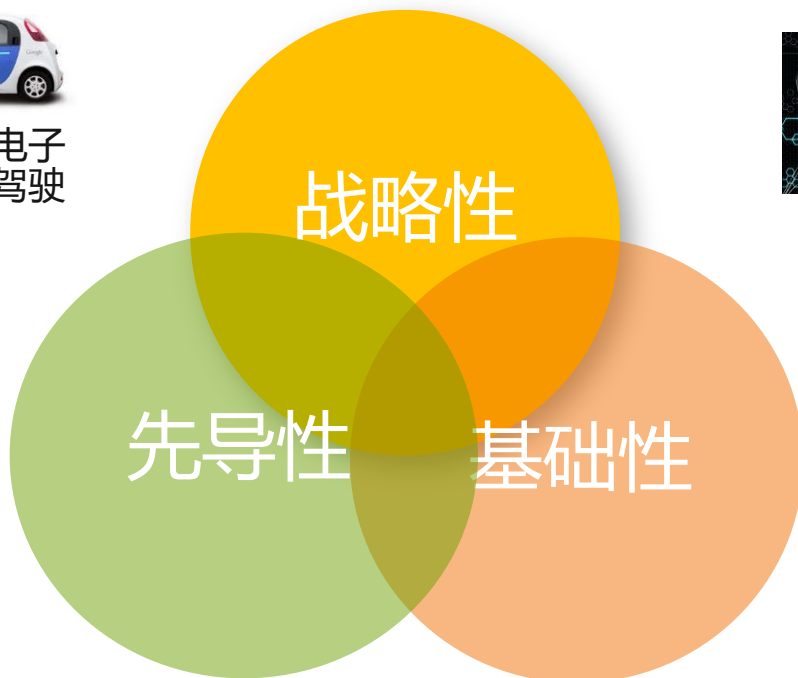
汽车电子
无人驾驶



人工智能



大数据
云计算
5G



物联网
可穿戴设备
智能家居
智能物流
智能工业



智能手机



平板电脑



笔记本电脑



数字电视



显示器



机顶盒

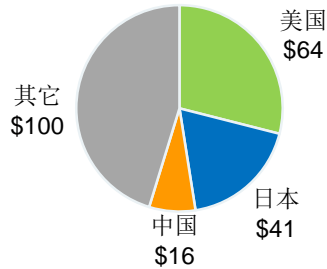
中国芯片市场快速成长

中国已成为全球最大芯片市场
(十亿美金)

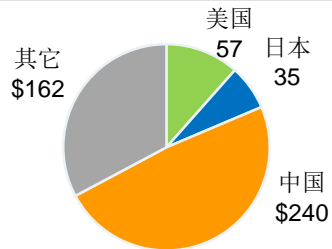
中国设计市场成长率
(十亿美金)

中芯来自于中国市场的收入
快速成长 (百万美金)

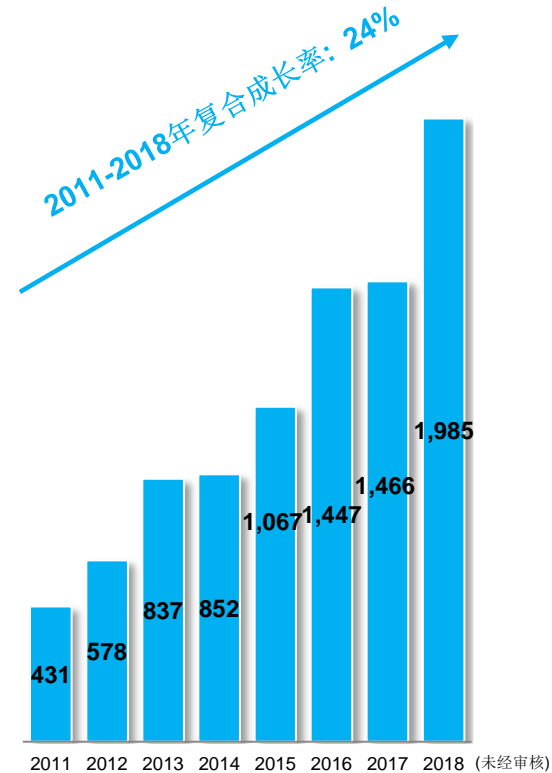
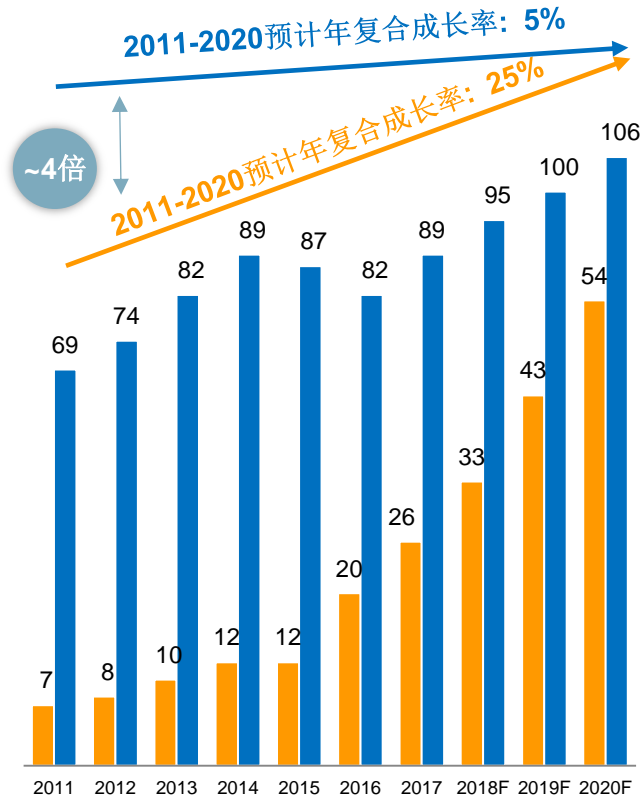
2000 - 中国市场份额: 7%



2018E - 中国市场份额: 49%



■ 中国设计 ■ 全球设计



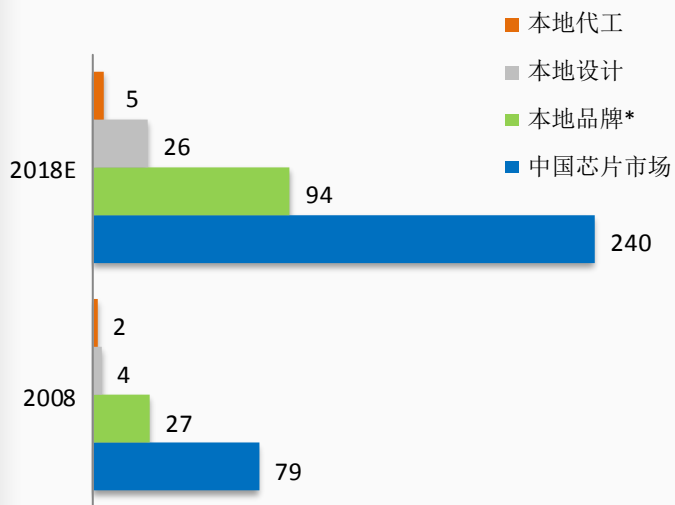
来源:
中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2019年1季度

来源:
中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2018年4季度



中国芯片市场驱动代工业成长

中国芯片市场,本地品牌,本地设计&本地代工
(十亿美金)



*包含本地系统公司

国内芯片消费市场体量巨大

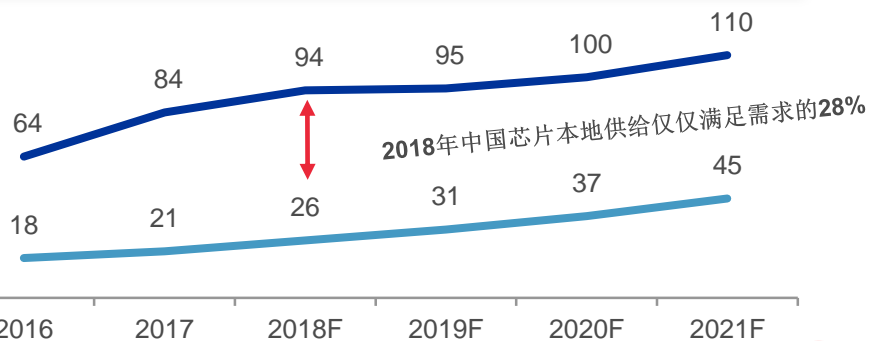
- 国内芯片消费占全球49%份额
- 2018年本地品牌购买芯片价值约940亿美元

来源:

中芯根据第三方数据分析得来,更新于2018年4季度



中国芯片需求和供给 (十亿美金)



来源:

中芯根据第三方数据分析得来,更新于2018年2季度

SMIC Presentation

All copyrights and IP belong to SMIC. For reference only and may not be copied or distributed without written permission from SMIC. SMIC shall not be responsible for any party's reliance on these materials.





- 中国集成电路产业机遇
- **中芯简介**
- 中芯业绩
- 成长战略
- 总结

中芯: 中国大陆地区规模最大, 技术最全面的集成电路晶圆代工厂

公司一览

- 成立于**2000**年, 总部位于上海
- 在**港交所**和**纽交所**上市
- 中国大陆**领先**的代工厂, 全球纯代工厂**前四**
- **2018**年未经审核收入:**33亿6千万美金**,**历史新高**

全球分布



股东结构

大唐控股	17.05%
国家集成电路产业投资基金	15.81%
其他全球投资人	67.14%

中芯在中国芯片生态链中的地位举足轻重



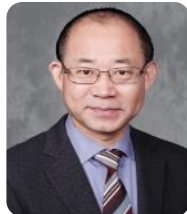
来源: NASDAQ OMX 公开数据, 2019年1月

独立兼国际化的董事会

执行董事



周子学
董事长



赵海军
联合首席执行官



梁孟松
联合首席执行官



高永岗
首席财务官

非执行董事



童国华
中国信科集团
董事长



陈山枝
中国信科集团
副总裁



路军
华芯投资
总裁



任凯
华芯投资
副总裁



周杰
海通证券
董事长

独立非执行董事



William Tudor Brown
安谋联合创办人



蒋尚义
台积电
首席运营官



丛京生
美国国家工程院院士
UCLA校长讲席教授



刘遵义
香港中文大学
讲座教授



范仁达
东源资本
主席



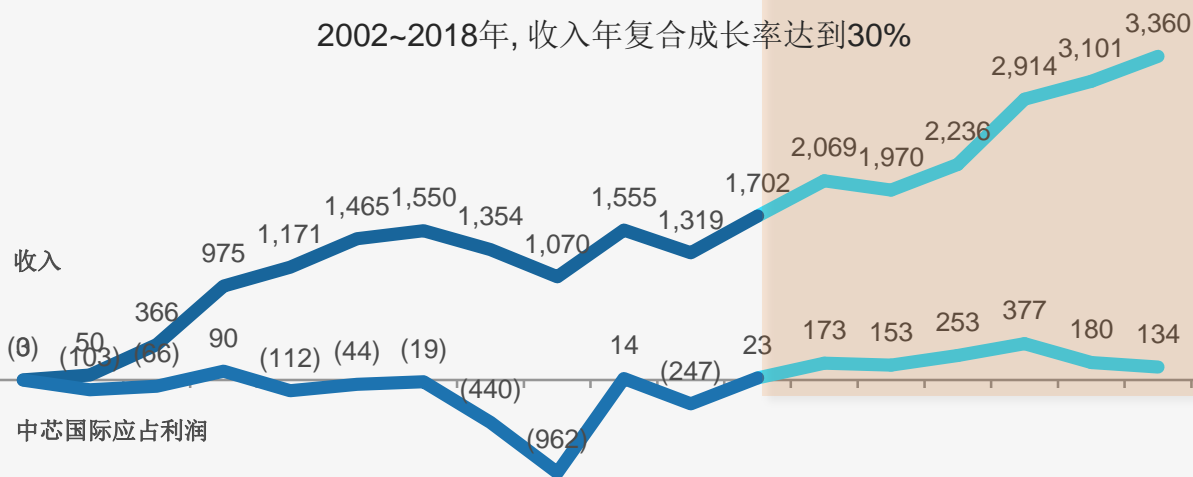
过渡期: 筑基扬帆

早期

扭亏为盈

砥砺前行,再创辉煌

2002~2018年, 收入年复合成长率达到30%



中国代工业首选

目标:

- 成为世界一流的主流代工厂
- 加速技术研发
- 建立关键平台和战略联盟

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (未经审核)

- 2000 成立
- 2002 8"投产; 实现收入
- 2004 在港交所和纽交所上市; 实现利润
- 2005 12"投产
- 2009 管理层变动

- 2012 扭亏为盈
- 2013 成立北京 12" 合资厂
- 2014 成立凸块加工合资厂
- 2016 与江阴长电建立战略合作关系; 收购LFoundry; 上海,天津和深圳新厂计划
- 2017 任命联合首席执行官
- 2018 成立上海 12" 合资厂



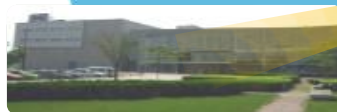
中芯产能布局



意大利
LF 8" 合资厂



北京
12" 厂
12" 合资厂



天津
8" 厂
8" 新厂



上海
8" 厂
12" 厂
12" 合资新厂



深圳
8" 厂
12" 厂

现有工厂

2018年末装机产能

上海 12"	10K
北京 12"	42K
北京合资 12"	33K
深圳 12"	小规模产线
上海 8"	109K
天津 8"	60K
深圳 8"	42K
意大利合资 LF 8"	42K

新厂

扩产前提:

- 市场和客户需求确定
- 技术准备就绪

上海合资 12"

- 控股合资厂, 14nm及更先进技术
- 合资方为国家集成电路基金和上海集成电路基金

天津 8"

- 有望成为世界单体规模最大的 8 英寸集成电路生产线





- 中国集成电路产业机遇
- 中芯简介
- **中芯业绩**
- 成长战略
- 总结

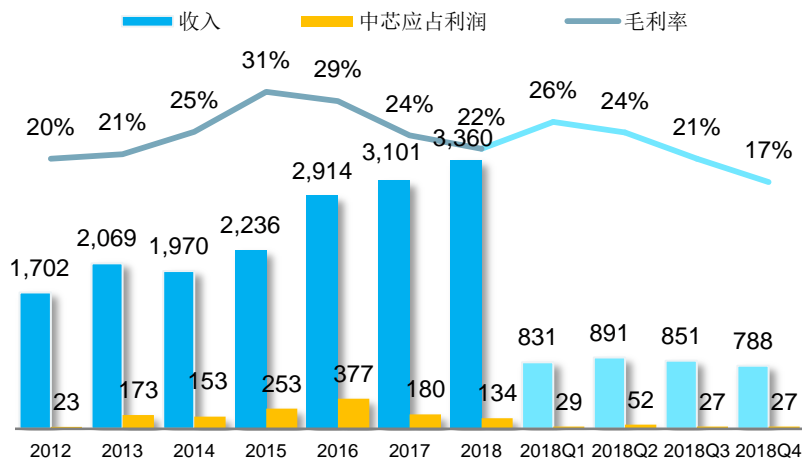
财务摘要

	2018年4季度指引	2018年4季度业绩	2019年1季度指引
收入	环比下降7%~9% 7亿7仟3百万~7亿8仟9百万美金	环比下降7.4% 7亿8仟8百万美金	环比下降16%~18% 6亿4仟6百万~6亿6仟2百万美金
毛利率	15%~17%	17.0%	20%~22%
非公认准则的经营开支 ⁽¹⁾	2亿2仟6百万~2亿3仟万美金	2亿4仟3百万美金	2亿5仟万~2亿5仟5百万美金
非控制权益 ⁽²⁾	2仟万~2仟2百万美金	1仟6百万美金	1仟万~1仟2百万美金

(1) 非公认准则的经营开支为扣除雇员花红计提数、政府项目资金、有形及无形资产的减值亏损、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响

(2) 非控制权益承担的损失

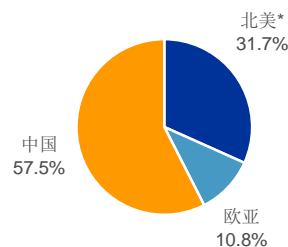
收入和获利 (百万美金)



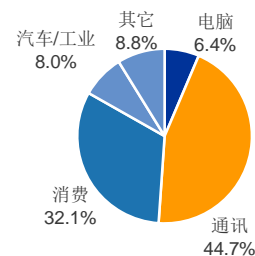
备注: 2013年以前的数据采用美国公认会计准则的财务报表, 2013年以后的数据采用国际财务报告准则。

收入来源多样

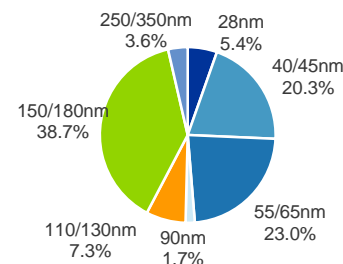
收入按地区分类



收入按应用分类



晶圆收入按制程分类



数据来源: 公司2018年4季度业绩

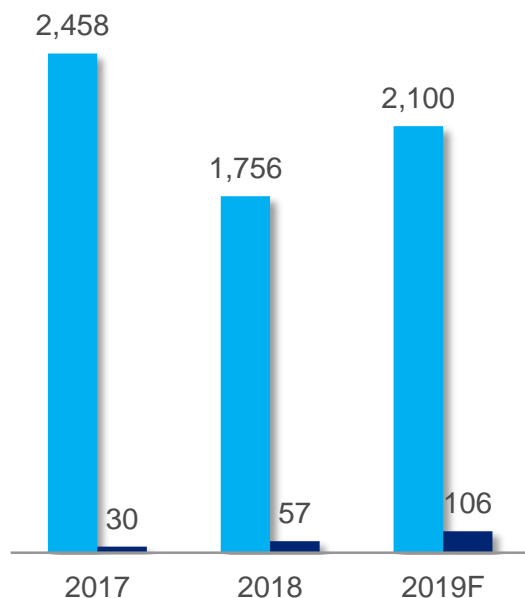
*呈列之收入为总公司位于美国, 但最终出售及付运产品予全球客户的公司。



资本开支, 税息折旧及摊销前利润, 及现金储备

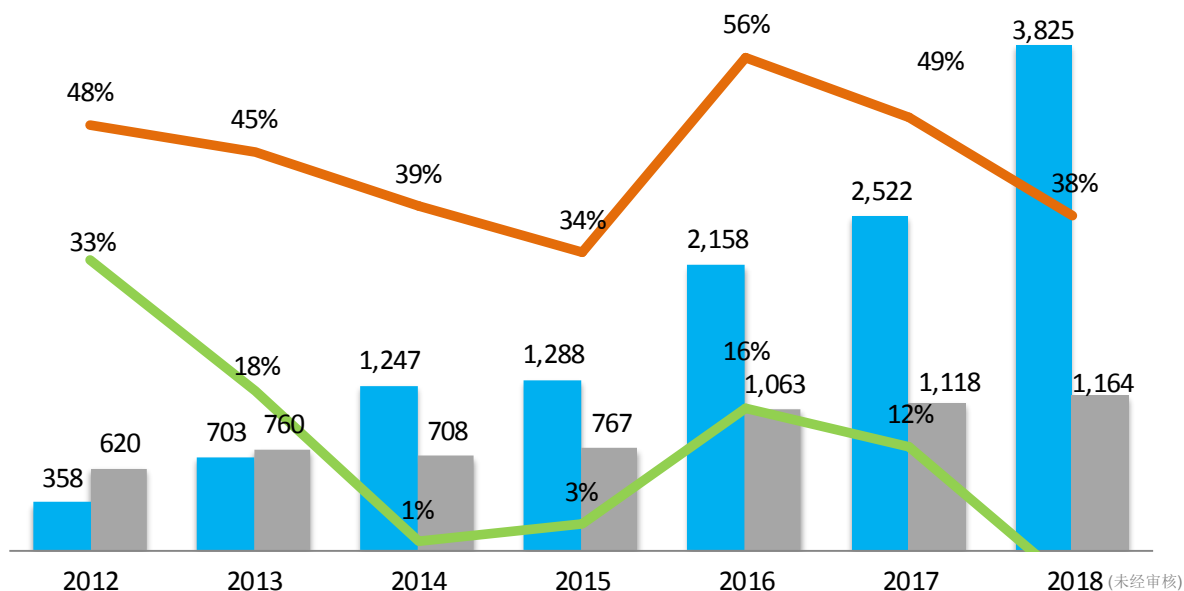
资本开支 (百万美金)

■ 用于晶圆厂运作 ■ 用于非晶圆厂运作



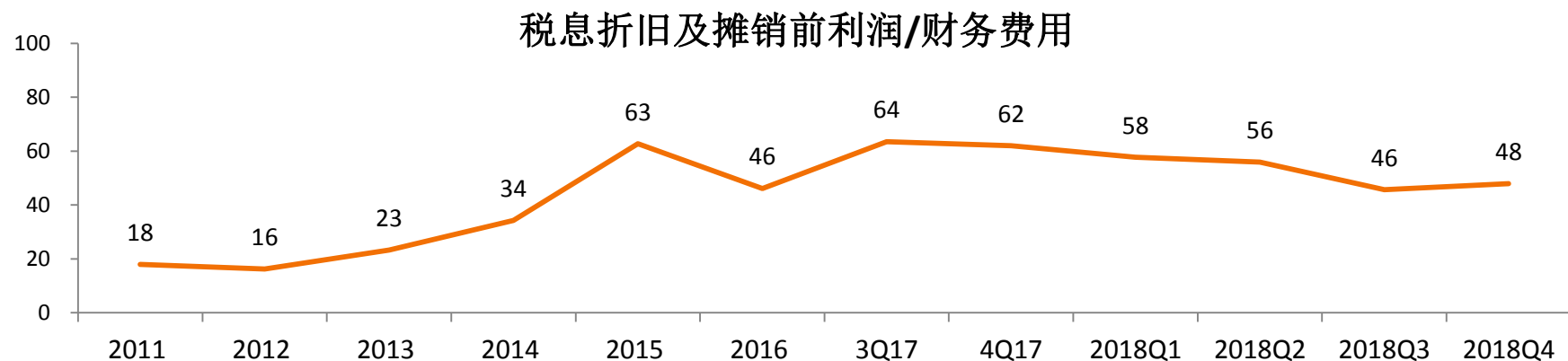
现金储备, 税息折旧及摊销前利润 (百万美金)

■ 含金融资产的现金 ■ 税息折旧及摊销前利润 ■ 总债务对权益比 ■ 净债务对权益比



投资级别信用评级

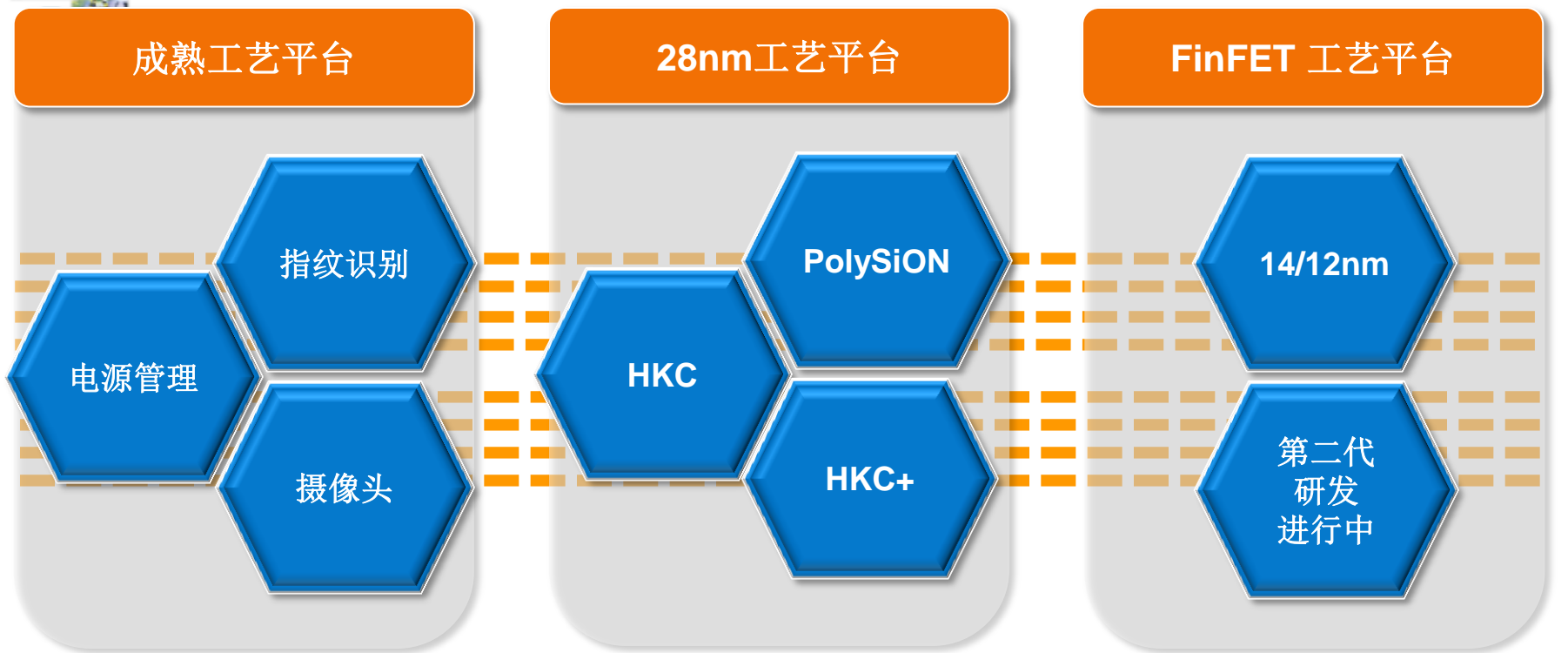
- 自2013年10月获得标准普尔**投资级别 BBB-** 长期公司评级
- 在2015年10月获得穆迪 **投资级别 Baa3** 公司评级
- 在2015年11月获得中诚信国际信用评级公司的**AAA**评级
- 致力于维持投资信用评级, **净债务对税息折旧及摊销前利润低于2x**





- 中国集成电路产业机遇
- 中芯简介
- 中芯业绩
- **成长战略**
- 总结

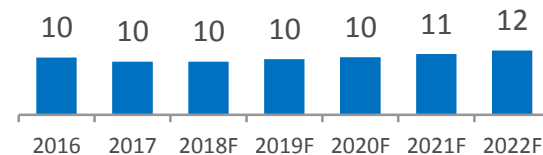
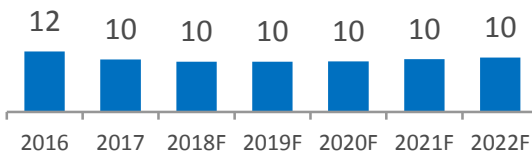
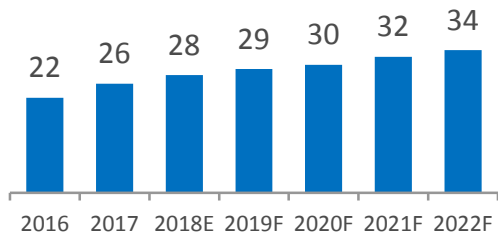
成长战略：多代技术并行开发，加速扩大潜在市场



电源+指纹识别+摄像头市场
(十亿美金)

28nm市场
(十亿美金)

14nm市场
(十亿美金)



来源: 中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2018年4季度

持续投入,推动成长,打造自主可控的知识产权体系

1

研发投入密集度持续提高,加速研发突破

2

缩短先进技术开发周期,缩小与领先者的差距

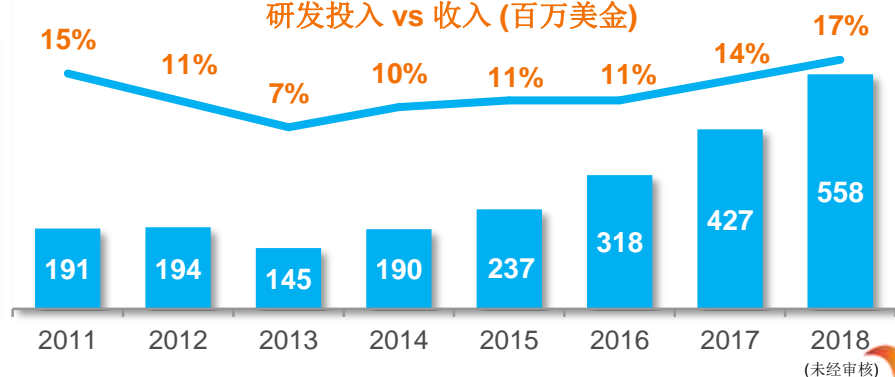
3

聚焦关键成熟平台持续优化和成本效率

累计专利授权



研发投入 vs 收入 (百万美金)

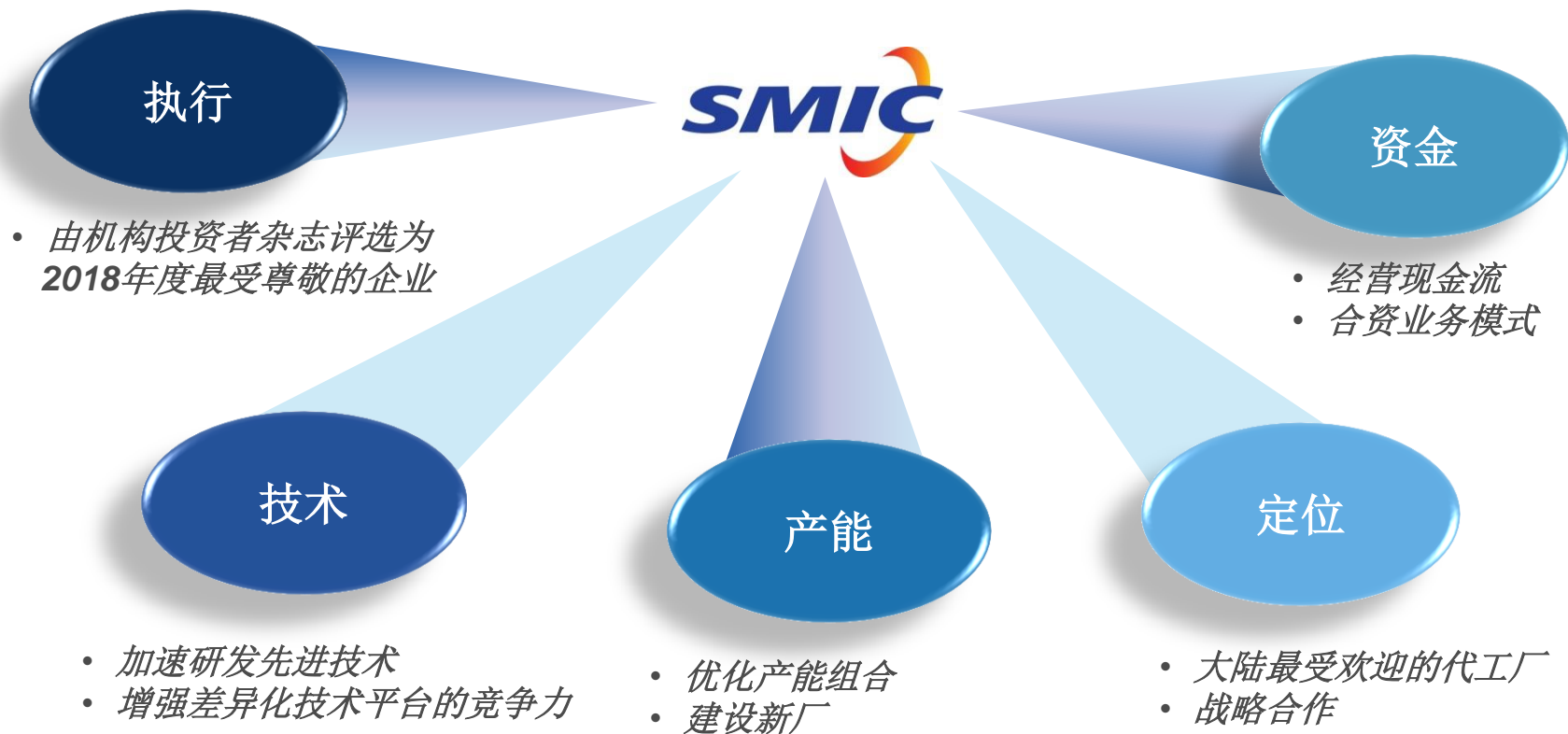




- 中国集成电路产业机遇
- 中芯简介
- 中芯业绩
- 成长战略
- **总结**



以成为世界一流晶圆代工企业为目标





谢 谢

联系我们: ir@smics.com

